

國立中興大學x台積電半導體學程說明會

掌握 半導體 知識 成為 定義未來 科技的領導者

台積電 人才招募部/ 廖晨瑄(Morgen) 2025-09-03

TSM(TO).



為自己贏得 3 份禮物

© 2025 TSMC, Ltd 1 TSMC Property





微學程修畢證書 (3門科目)



(說自己的故事)

半導體微學程 (最低須修畢 3 門科目)



修畢門檻:

- 1. 修畢所就讀理工科系大學部所有系訂必修科目(憑成績單)
- 2. + 修畢半導體學程中的「半導體製程」科目
- 3. + 修畢半導體學程中,任兩門「必修」或「核心選修」科目

透過學程系統申請通過

台積即授予「半導體微學程修畢證書」



微學程修畢證書 (3門科目)

舉例:A選擇報名半導體學程(最低須修畢 11 門科目)



必修(11選3)

核心選修(26選5)(可用必修抵)

- 1 電子學一
- 2 半導體元件物理
- 3 半導體製程
- 4 電路學
- 5 材料分析與檢測
- 6 分析化學
- 7 流體力學/輸送現象一
- 8 電子封裝技術
- 9 半導體製程設備與技術
- 10 機器人與自動化應用
- 11 實驗設計與統計應用

- 1 電子學二
- 2 微分方程/工程數學一
- 3 線性代數/工程數學二
- 4 固態物理
- 5 電磁學
- 6 積體電路設計
- 7 微電子工程
- 8 電子薄膜科技
- 9 電漿工程與應用
- 10 材料科學
- 11 熱力學

- 14 材料表面工程
- 15 物理化學
- 16 有機化學
- 17 材料化學
- 18 異質整合製造與技術
- 19 電機機械
- 20 機電整合與自動化應用
- 21 感測技術基礎科學
- 22 機構設計與加工
- 23 化學工程
- 24 材料力學

於學程系統提出(微學程)修畢證書申請,檢具

- 1. 成績單 (完成科目以螢光筆註記)
- 2. 學士學位證書掃描檔 (用以佐證完成系訂必修)

專業選修(27選3)(可用必修/核心選修抵)

- 1 近代物理
- 2 量子物理/量子力學
- 3 半導體元件設計與模擬
- 4 半導體元件量測
- 5 應用光電子學
- 6 先進製程特論
- 7 電子繞射顯微術
- 8 物理光學
- 9 材料機械性質
- 10 熱傳導/輸送現象二
- 11 擴散與相變化
- 12 無機化學
- 13 電子材料
- 14 高分子科學

- 15 化學/化工動力學
- 16 真空技術
- 17 電腦輔助工程
- 18 電化學原理
- 19 可靠度工程
- 20 複合物半導體元件
- 21 材料物理性質
- 22 應力分析
- 23 固體力學
- 24 智慧製造技術
- 25 量測原理
- 26 機器學習/深度學習
- 27 半導體實務@tsmc

Genal Humber: 2023031200 13-172100

© 2025 TSMC, Ltd 4 TSMC Property





微學程修畢證書 (3門科目)

(說自己的故事)



台積新人訓練中心 結訓證書



(台積主管很買單) (**必須報名半導體學程)**

到台積新人訓練中心(NTC) 報名學程是 必要條件





台積業師講授專屬課程



	(.0									
代碼	5122	無課程代碼,由台積邀請學程學生自由參加								
開課	機械工程學系	台積新人訓練中心								
單位	(邱顯俊 副教授)	(平日)04/08 - , 04/11 - , 10/29 - , 11/07 - , (暑假)08/04 - 08/07								
課程	半導體製程設備與技術	半導體機台基礎	半導體設備元件基礎							
名稱	(必修)	(選修)	(選修)							
課程目標	介紹並使學生了解半導體儀器與設備相關技術及發展趨勢,並鏈結各工程領域與半導體產業之知識及人才	 對機台設計原理、操作與預防保養有基礎概念 初步了解半導體設備實務工作內涵 結合學校所學與產業實務 	 對設備元件原理與作用有基礎認識 初步了解半導體設備實務工作內涵 結合學校所學與產業實務 							
實施	一學期	4個週]六/ 梯							
方式	由台積業師輔助授課	至台積新人訓約	陳中心接受訓練							
3	<mark>(114學年度第2學期)</mark>	(含保險、交通)	妾駁、用餐安排)							





微學程修畢證書 (3門科目)

(說自己的故事)



台積新人訓練中心 結訓證書



(台積主管很買單) (必須報名半導體學程)



台積半導體學程 修畢證書



(產業敲門磚)

(11門科目)

erial number: 202509120813-17210039

© 2025 TSMC, Ltd 8

修畢半導體學程,您將...





修滿學程規定科目者,經審查 無誤後,由台積授予**「學程修 畢證明書」。**



符合指定條件並獲錄取者,台積將提供新台幣 15 萬元學程獎勵金。(到職首個撥薪日發放)

指定條件:

- 1.學程科目修業平均成績達 80 分(含)以上
- 2.碩一(含)以前報名學程
- 3. 畢業後直接加入台積
- 4. 獲聘書(含預聘)前已上傳修畢證書至台積人才資料庫



澄清您的疑惑



- 1. 需要額外繳學分費嗎? 不用
- 2. 沒修完會有什麼影響嗎? 不會(虛擬學程)
- 3. 要怎麼修課? 透過學校選課系統選課



4. 碩士班不是唸中興,修業紀錄可以帶著跑嗎? 可抵修

大學部修業紀錄皆可提出抵修 @台積學程合作學校



學程類別	清大	成大	陽明 交大	臺大	臺灣 科大		中山	中央	中興	中正	逢甲	元智	中原			屏東 科大			
半導體 元件整合 製程模組	•	•	•	•	00	2	•	•		•		3	•	•	•	•	3	•	
設備工程 電路設計			•	•	•														
智慧製造		C									•						*依合作	開辦順	序排列
SACO					S	S. S.	Serial nu	mber: 2()250912	0813-17	210039						1		

© 2025 TSMC, Ltd 11 TSMC Property

↑ 立即掃描QR Code報名修讀學程

Scan me!



https://careers.tsmc.com/education

修讀學程好處:

- ▶ 能參與學程學生專屬活動
- ▶ 修畢學程且成績達標,錄取台 積時可享有學程獎勵金

學程承辦窗口

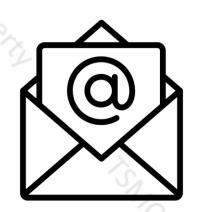
Sam Chern (陳昕哲) hcchern@tsmc.com 0978-211-692 Morgen Liao (廖晨瑄) chliaoam@tsmc.com 0978-210-393

學程系統窗口

Jenny Cheng (鄭惠甄) hjchenge@tsmc.com 0988-937-550

報名修讀毋須**月壓刀!報名後若木順利達成修畢門檻,僅無**法獲得 學程修畢證書·完全不影響在校任何成績或表現喔!





來信諮詢學程相關事宜 請於信末留下 手機號碼 方便聯繫

(雙向溝通 容易釐清問題所在)

用 私人電子郵件 註冊帳號 報名學程





報名 半導體學程



報名 學生專屬活動



應徵 台積職缺 (搜尋職缺)

讓學程修業資訊 與您的履歷勾稽在一起

Serial number: 202509120813-17210039

© 2025 TSMC, Ltd 14 TSMC Property



暑期實習 優先邀請學程學生面談(大三以上)



© 2025 TSMC, Ltd 15



修畢且成績達標 給予學程獎勵金



© 2025 TSMC, Ltd 16 TSMC Property





國立中興大學 x 台積電 半導體學程合作系所



研究發展處

宋振銘 研發長

電機工程學系

材料科學與工程學系

物理學系

化學工程學系

機械工程學系

生物產業機電工程學系

楊清淵

教授兼系主任

林佳鋒

教授兼系主任

鄭建宗

教授兼系主任

李思禹

教授兼系主任

簡瑞與

特聘教授兼系主任

蔡燿全

副教授兼系主任

統整學程 提高學生修業彈性並擴大學生參與



113學年度第2學期(含以前)

114學年度第1學期起

電路設計學程

電路設計學程

元件整合學程

製程暨封裝學程

設備工程學程

半導體學程

半導體學程(最低須修畢11門科目;8門必/核心選修及3門專業選修)



必修(11選3)

- 電子學一
- 2 半導體元件物理
- 3 半導體製程
- 4 電路學
- 5 材料分析與檢測
- 6 分析化學
- 7 流體力學/輸送現象一
- 8 電子封裝技術
- 9 半導體製程設備與技術
- 10 機器人與自

11

台積業師 輔助授課

應用

核心選修(26選5)(可以用必修抵)

- 1 電子學二
- 2 微分方程/工程數學一
- 3 線性代數/工程數學二
- 4 固態物理
- 5 電磁學
- 6 積體電路設計
- 7 微電子工程
- 8 電子薄膜科技
- 9 電漿工程與應用
- 10 材料科學
 - 熱力學
 - 2 物理冶金
 - 3 表面物理/表面化學

- 14 材料表面工程
- 15 物理化學
- 16 有機化學
- 17 材料化學
- 18 異質整合製造與技術
- 19 電機機械
- 20 機電整合與自動化應用
- 21 感測技術基礎科學
- 22 機構設計與加工
- 23 化學工程
- 24 材料力學
- 25 微機電技術
- 26 程式語言

專業選修(27選3)(可以用必修/核心選修抵)

- 1 近代物理
- 2 量子物理/量子力學
- 3 半導體元件設計與模擬
- 4 半導體元件量測
- 5 應用光電子學
- 6 先進製程特論
- 7 電子繞射顯微術
- 8 物理光學
- 9 材料機械性質
- 10 熱傳導/輸送現象二
- 11 擴散與相變化
- 12 無機化學
- 13 電子材料
- 14 高分子科學

- 15 化學/化工動力學
- 16 真空技術
- 17 電腦輔助工程
- 18 電化學原理
- 19 可靠度工程
- 20 複合物半導體元件
- 21 材料物理性質
- 22 應力分析
- 23 固體力學
- 24 智慧製造技術
- 25 量測原理
- 26 機器學習/深度學習
- 27 半導體實務@tsmc

台積新人訓練中心 半導體實作課程

Serial number: 202509120813-17210039

© 2025 TSMC, Ltd 20 TSMC Property

台積業師講授專屬課程



代碼	5122	無課程代碼,由台積邀請學程學生自由參加								
開課	機械工程學系	台積新人訓練中心								
單位	(邱顯俊 副教授)	(平日)04/08 - , 04/11 - , 10/29 - , 11/07 - , (暑假)08/04 - 08								
課程	半導體製程設備與技術	半導體機台基礎	半導體設備元件基礎							
名稱	(必修)	(選修)	(選修)							
課程目標	介紹並使學生了解半導體儀器與 設備相關技術及發展趨勢,並鏈 結各工程領域與半導體產業之知 識及人才	 對機台設計原理、操作與預防保養有基礎概念 初步了解半導體設備實務工作內涵 結合學校所學與產業實務 	 對設備元件原理與作用有基礎認識 初步了解半導體設備實務工作內涵 結合學校所學與產業實務 							
實施	一學期	4個遁	1六/梯							
方式	由台積業師輔助授課	至台積新人訓約	練中心接受訓練							
30	<mark>(114學年度第2學期)</mark>	(含保險、交通	接駁、用餐安排)							

(電機)半導體學程(最低須修畢11門科目;8門必/核心選修及3門專業選修)



必修(11選3)

- 電子學一
- 2 半導體元件物理
- 3 半導體製程
- 4 電路學
- 5 材料分析與檢測
- 6 分析化學
- 7 流體力學/輸送現象一
- 8 電子封裝技術
- 9 半導體製程設備與技術
- 10 機器人與自動化應用
- 11 實驗設計與統計應用

核心選修(26選5)(可以用必修抵)

- 1 電子學二
- 2 微分方程/工程數學一
- 3 線性代數/工程數學二
- 4 固態物理
- 5 電磁學
- 6 積體電路設計
- 7 微電子工程
- 8 電子薄膜科技
- 9 電漿工程與應用
- 10 材料科學
- 11 熱力學
- 12 物理冶金
- 13 表面物理/表面化學

- 14 材料表面工程
- 15 物理化學
- 16 有機化學
- 17 材料化學
- 18 異質整合製造與技術
- 19 電機機械
- 20 機電整合與自動化應用
- 21 感測技術基礎科學
- 22 機構設計與加工
- 23 化學工程
- 24 材料力學
- 25 微機電技術
- 26 程式語言

專業選修(27選3)(可以用必修/核心選修抵)

- 1 近代物理
- 2 量子物理/量子力學
- 3 半導體元件設計與模擬
- 4 半導體元件量測
- 5 應用光電子學
- 6 先進製程特論
- 7 電子繞射顯微術
- 8 物理光學
- 9 材料機械性質
- 10 熱傳導/輸送現象二
- 11 擴散與相變化
- 12 無機化學
- 13 電子材料
- 14 高分子科學

- 15 化學/化工動力學
- 16 真空技術
- 17 電腦輔助工程
- 18 電化學原理
- 19 可靠度工程
- 20 複合物半導體元件
- 21 材料物理性質
- 22 應力分析
- 23 固體力學
- 24 智慧製造技術
- 25 量測原理
- 26 機器學習/深度學習
- 27 半導體實務@tsmc

電機系大學部科目



電機系研究所科目



建議多修科目

Serial number: 202509120813-17210039

© 2025 TSMC, Ltd 22 TSMC Property

(材料)半導體學程(最低須修畢11門科目;8門必/核心選修及3門專業選修)



必修(11選3)

、<mark>電子學一</mark>

- 2 半導體元件物理
- 3 半導體製程
- 4 電路學
- 5 材料分析與檢測
- 6 分析化學
- 7 流體力學/輸送現象一
- 8 電子封裝技術
- 9 半導體製程設備與技術
- 10 機器人與自動化應用
- 11 實驗設計與統計應用

核心選修(26選5)(可以用必修抵)

- 1 電子學二
- 2 微分方程/工程數學一
- 3 線性代數/工程數學二
- 4 固態物理
- 5 電磁學
- 6 積體電路設計
- 7 微電子工程
- 8 電子薄膜科技
- 9 電漿工程與應用
- 10 <mark>材料科學</mark>
- **11** <mark>熱力學</mark>
- 12 <mark>物理冶金</mark>
- 13 表面物理/表面化學

- 14 材料表面工程
- 15 物理化學
- **16** 有機化學
- 17 材料化學
- 18 異質整合製造與技術
- 19 電機機械
- 20 機電整合與自動化應用
- 21 感測技術基礎科學
- 22 機構設計與加工
- 23 化學工程
- 24 材料力學
- 25 微機電技術
- 26 程式語言

專業選修(27選3)(可以用必修/核心選修抵)

- 1 近代物理
- 2 量子物理/量子力學
- 3 半導體元件設計與模擬
- 4 半導體元件量測
- 5 應用光電子學
- 6 先進製程特論
- 7 電子繞射顯微術
- 8 物理光學
- 9 材料機械性質
- 10 熱傳導/輸送現象二
- 11 擴散與相變化
- 12 無機化學
- 13 電子材料
- l4 <mark>高分子科學</mark>

- 15 化學/化工動力學
- 16 真空技術
- 17 電腦輔助工程
 - 8 電化學原理
- 19 可靠度工程
- 20 複合物半導體元件
- 21 材料物理性質
- 22 應力分析
- 23 固體力學
- 24 智慧製造技術
- 25 量測原理
- 26 機器學習/深度學習
- 27 半導體實務@tsmc

材料系大學部科目



材料系研究所科目



建議多修科目

Serial number: 202509120813-17210039

© 2025 TSMC, Ltd 23 TSMC Property

(物理)半導體學程(最低須修畢11門科目;8門必/核心選修及3門專業選修)



必修(11選3)

- <mark>電子學一</mark>
- 2 半導體元件物理
- 3 半導體製程
- 4 電路學
- 5 材料分析與檢測
- 6 分析化學
- 7 流體力學/輸送現象一
- 8 電子封裝技術
- 9 半導體製程設備與技術
- 10 機器人與自動化應用
- 11 實驗設計與統計應用

核心選修(26選5)(可以用必修抵)

- 1 <mark>電子學二</mark>
- 2 微分方程/工程數學一
- 3 線性代數/工程數學二
- 4 固態物理
- 5 電磁學
- 6 積體電路設計
- 7 微電子工程
- 8 電子薄膜科技
- 9 電漿工程與應用
- 10 材料科學
- 11 熱力學
- 12 物理冶金
- 13 表面物理/表面化學

- 14 材料表面工程
- 15 物理化學
- 16 有機化學
- 17 材料化學
- 18 異質整合製造與技術
- 19 電機機械
- 20 機電整合與自動化應用
- 21 感測技術基礎科學
- 22 機構設計與加工
- 23 化學工程
- 24 材料力學
- 25 微機電技術
- 26 程式語言

專業選修(27選3)(可以用必修/核心選修抵)

- 1 近代物理
- 2 量子物理/量子力學
- 3 半導體元件設計與模擬
- 4 半導體元件量測
- 5 應用光電子學
- 6 先進製程特論
- 7 電子繞射顯微術
- 8 物理光學
- 9 材料機械性質
- 10 熱傳導/輸送現象二
- 11 擴散與相變化
- 12 無機化學
- 13 電子材料
- 14 高分子科學

- 15 化學/化工動力學
- 16 真空技術
- 17 電腦輔助工程
- 18 電化學原理
- 19 可靠度工程
- 20 複合物半導體元件
- 21 材料物理性質
- 22 應力分析
- 23 固體力學
- 24 智慧製造技術
- 25 量測原理
- 26 機器學習/深度學習
- 27 半導體實務@tsmc

物理系大學部科目



物理系研究所科目



建議多修科目

Serial number: 202509120813-17210039

© 2025 TSMC, Ltd 24 TSMC Property

(化工)半導體學程(最低須修畢11門科目;8門必/核心選修及3門專業選修)



必修(11選3)

- 1 電子學一
- 2 半導體元件物理
- 3 半導體製程
- 4 電路學
- 5 材料分析與檢測
- 6 分析化學
- 7 流體力學/輸送現象一
- 8 電子封裝技術
- 9 半導體製程設備與技術
- 10 機器人與自動化應用
- 11 實驗設計與統計應用

核心選修(26選5)(可以用必修抵)

- 1 電子學二
- 2 微分方程/工程數學一
- 3 線性代數/工程數學二
- 4 固態物理
- 5 電磁學
- 6 積體電路設計
- 7 微電子工程
- 8 電子薄膜科技
- 9 電漿工程與應用
- 10 <mark>材料科學</mark>
- **11** 熱力學
- 12 物理冶金
- 13 表面物理/表面化學

- 14 材料表面工程
- 15 <mark>物理化學</mark>
- **16** 有機化學
- 17 材料化學
- 18 異質整合製造與技術
- 19 電機機械
- 20 機電整合與自動化應用
- 21 感測技術基礎科學
- 22 機構設計與加工
- 23 化學工程
- 24 材料力學
- 25 微機電技術
- 26 程式語言

專業選修(27選3)(可以用必修/核心選修抵)

- 1 近代物理
- 2 量子物理/量子力學
- 3 半導體元件設計與模擬
- 4 半導體元件量測
- 5 應用光電子學
- 6 先進製程特論
- 7 電子繞射顯微術
- 8 物理光學
- 9 材料機械性質
- 10 熱傳導/輸送現象二
- 11 擴散與相變化
- 12 無機化學
- 13 電子材料
- l4 <mark>高分子科學</mark>

- 15 化學/化工動力學
- 16 真空技術
- 17 電腦輔助工程
- 18 <mark>電化學原理</mark>
- 19 可靠度工程
- 20 複合物半導體元件
- 21 材料物理性質
- 22 應力分析
- 23 固體力學
- 24 智慧製造技術
- 25 量測原理
- 26 機器學習/深度學習
- 27 半導體實務@tsmc

化工系大學部科目



化工系研究所科目



建議多修科目

Serial number: 202509120813-17210039

© 2025 TSMC, Ltd 25

(機械)半導體學程(最低須修畢11門科目;8門必/核心選修及3門專業選修)



必修(11選3)

- L <mark>電子學一</mark>
- 2 半導體元件物理
- 3 半導體製程
- 4 電路學
- 5 材料分析與檢測
- 6 分析化學
- 7 流體力學/輸送現象一
- 8 電子封裝技術
- 9 半導體製程設備與技術
- 10 機器人與自動化應用
- 11 實驗設計與統計應用

核心選修(26選5)(可以用必修抵)

- 1 電子學二
- 2 微分方程/工程數學一
- 3 線性代數/工程數學二
- 4 固態物理
- 5 電磁學
- 6 積體電路設計
- 7 微電子工程
- 8 電子薄膜科技
- 9 電漿工程與應用
- 10 材料科學
- 11 熱力學
- 12 物理冶金
- 13 表面物理/表面化學

- 14 材料表面工程
- 15 物理化學
- 16 有機化學
- 17 材料化學
- 18 異質整合製造與技術
- 19 電機機械
- 20 機電整合與自動化應用
- 21 感測技術基礎科學
- 22 機構設計與加工
- 23 化學工程
- 24 材料力學
- 25 微機電技術
- 26 程式語言

專業選修(27選3)(可以用必修/核心選修抵)

- 1 近代物理
- 2 量子物理/量子力學
- 3 半導體元件設計與模擬
- 4 半導體元件量測
- 5 應用光電子學
- 6 先進製程特論
- 7 電子繞射顯微術
- 8 物理光學
- 9 材料機械性質
- 10 熱傳導/輸送現象二
- 11 擴散與相變化
- 12 無機化學
- 13 電子材料
- 14 高分子科學

- 15 化學/化工動力學
- 16 真空技術
- 17 電腦輔助工程
- 18 電化學原理
- 19 可靠度工程
- 20 複合物半導體元件
- 21 材料物理性質
- 22 應力分析
- 23 固體力學
- 24 智慧製造技術
- 25 量測原理
- 26 機器學習/深度學習
- 27 半導體實務@tsmc

電機系大學部科目



電機系研究所科目



建議多修科目

Serial number: 202509120813-1721003

© 2025 TSMC, Ltd 26 TSMC Property

(生機)半導體學程(最低須修畢11門科目;8門必/核心選修及3門專業選修)



必修(11選3)

電子學一

- 2 半導體元件物理
- 3 半導體製程
- 4 電路學
- 5 材料分析與檢測
- 6 分析化學
- 7 流體力學/輸送現象一
- 8 電子封裝技術
- 9 半導體製程設備與技術
- 10 機器人與自動化應用
- 11 實驗設計與統計應用

核心選修(26選5)(可以用必修抵)

- 1 電子學二
- 2 微分方程/工程數學一
- 3 線性代數/工程數學二
- 4 固態物理
- 5 電磁學
- 6 積體電路設計
- 7 微電子工程
- 8 電子薄膜科技
- 9 電漿工程與應用
- 10 材料科學
- **11** 熱力學
- 12 物理冶金
- 13 表面物理/表面化學

- 14 材料表面工程
- 15 物理化學
- 16 <mark>有機化學</mark>
- 17 材料化學
- 18 異質整合製造與技術
- 19 電機機械
- 20 機電整合與自動化應用
- 21 感測技術基礎科學
- 22 機構設計與加工
- 23 化學工程
- 24 材料力學
- 25 微機電技術
- 26 程式語言

專業選修(27選3)(可以用必修/核心選修抵)

- 1 近代物理
- 2 量子物理/量子力學
- 3 半導體元件設計與模擬
- 4 半導體元件量測
- 5 應用光電子學
- 6 先進製程特論
- 7 電子繞射顯微術
- 8 物理光學
- 9 材料機械性質
- 10 熱傳導/輸送現象二
- 11 擴散與相變化
- 12 無機化學
- 13 電子材料
- 14 高分子科學

- 15 化學/化工動力學
- 16 真空技術
- 17 電腦輔助工程
- 18 電化學原理
- 19 可靠度工程
- 20 複合物半導體元件
- 21 材料物理性質
- 22 應力分析
- 23 固體力學
- 24 智慧製造技術
- 25 量測原理
- 26 機器學習/深度學習
- 27 半導體實務@tsmc

生機系大學部科目



生機系研究所科目



建議多修科目

Serial number: 202509120813-17210039

© 2025 TSMC, Ltd 27 TSMC Property

全球第一個使用最先進製程技術的【C設計團隊



設計暨技術平台(Design and Technology Platform)

(2,000+@台灣、美西、加拿大、日本、上海、南京)



© 2025 TSMC, Ltd 28

前瞻電路設計學程(最低須修畢11門科目;5門必修及至少6門選修)



必修

選修<mark>(2領域擇1)</mark>

- 1. <mark>電子學</mark>
- 2. 電路學
- 3. 邏輯設計
- 4. <mark>積體電路設計導論/</mark> 超大型積體電路設計
- 5. <mark>機率/統計學</mark>

數位電路設計

(Digital Design) (至少修6門)

- 1. 計算機結構
- 2. 積體電路設計實驗
- 3. 數位系統設計
- 4. 內嵌式記憶體電路設計
- 5. 超大型積體電路測試
- 6. 數位訊號處理架構設計
- 7. 電腦輔助積體電路系統設計
- 8. 超大型積體電路量產可行性設計
- 9. 系統晶片設計
- 10.數位積體電路分析與設計

電子設計自動化/設計流程

(EDA/Design Flow) (至少修6門)

- _____ 1. <mark>資料結構</mark>
- 2. 演算法
- 3. 計算機結構
- 4. 積體電路設計自動化
- 5. 實體設計自動化
- 6. 數位系統設計
- 7. 邏輯合成與驗證
- 8. 電腦輔助分析與最佳化
- 9. 機器學習
- 10.最佳化理論與應用



電機系大學部科目

Serial number: 202509120615-17210

© 2025 TSMC, Ltd 29 TSMC Property

報名後請下載 學程科目對照表 獲得學習指引





半導體學程 捜

關於台積公司

登入/註冊

學校	國立中興大學
最低修畢科目數	11 3
修畢門檻	2門必修 + 6門必選修 + 3門選修
學程負責人	學程系統相關問題: 鄭惠甄 HJCHENGE@TSMC.COM 學程其他問題: 陳昕哲 HCCHERN@TSMC.COM、 廖晨瑄 CHLIAOAM@TSMC.COM

☐ (f) in_® X

申請

學程說明

- 1. 修畢半導體學程將享有以下權益:
- 獲頒修畢證書: 修滿學程規定科目與學分者, 經主持系所審查無誤後, 由台積授予「學程修畢證明書」,
- 獲得面試保證: 獲頒「學程修畢證明書」者,申請台積職缺將保證獲得面試機會。
- 獲學程獎勵金: 台積將提供獎勵金給學程修業平均成績達80分(含)以上、碩一(含)前已註冊學程系統、於獲台積正職職缺聘書(含預聘)前已上傳學程修畢證書至台積履歷系統、(取得最高學歷)畢業後直接加入台積者。
- 2.半導體學程科目之必修/必選修/選修、課程抵修採認規定,不代表在校課程修業規範。
- 3. 報名後未修畢本學程者,僅無法獲得本學程之修畢證書,不影響學生在校任何成績或表現。
- 4. 報名半導體學程者,將有機會受邀參加學程專屬系列活動。
- 5. 「取得學程修畢證書,保證面試」適用範圍僅限台積公司台灣廠區(TSMC Taiwan),不適用海外子公司。
- 6. 台灣積體電路製造股份有限公司針對以上方案保留修改及解釋之權利。

▶ 科目對照表

Serial number: 202509120813-17210039

啟用 Windows 移至 [設定] 以啟用 Wi

↑ 立即掃描QR Code報名修讀學程

Scan me!



https://careers.tsmc.com/education

修讀學程好處:

- ▶ 能參與學程學生專屬活動
- ▶ 修畢學程且成績達標,錄取台 積時可享有學程獎勵金

學程承辦窗口

Sam Chern (陳昕哲) hcchern@tsmc.com 0978-211-692

學程系統窗口

Jenny Cheng (鄭惠甄) hjchenge@tsmc.com 0988-937-550 Morgen Liao (廖晨瑄) chliaoam@tsmc.com 0978-210-393

報名修讀毋須有壓力!報名後若未順利達成修畢門檻,僅無法獲得 學程修畢證書,完全不影響在校任何成績或表現喔!











半導體學程

與國內多所大學合作規劃半導體學程,共同定義先進半導體人才應具備的專業知能 與對應的課程藍圖,引導學生學習與準備 方向,建立紮實學理基礎



1

國立中興大學

請選擇類別

Q 捜尋

7 結果

已套用篩選條件(重設)

國立中興大學 - 製程/模組學程 (113學年度起適用)

國立中興大學

國立中興大學 - 先進封裝學程 (113學年度起適用)

國立中興大學

Serial number: 202509120813-17210039

3

□ 學程詳情

△ 分享

□ 學程詳情

△ 分享

啟用 Window 移至[設定] 以啟

5

台積公司職涯

學校	國立中興大學	SZ	申請
最低修畢科目數	11	Co	分享
修畢門檻	2門必修 + 6門必選修 + 3門選修	900	
學程負責人	學程系統相關問題: 鄭惠甄 HJCHENGE@TSMC.COM 學程其他問題: 陳昕哲 HCCHERN@TSMC.COM、 廖晨瑄 CHLIAOAM@TSMC.COM		

學程說明

- 1. 修畢半導體學程將享有以下權益:
- 獲頒修畢證書:修滿學程規定科目與學分者,經主持系所審查無誤後,由台積授予「學程修畢證明書」。
- 獲得面試保證: 獲頒「學程修畢證明書」者,申請台積職缺將保證獲得面試機會。
- 獲學程獎勵金: 台積將提供獎勵金給學程修業平均成績達80分(含)以上、碩一(含)前已註冊學程系統、於獲台積正職職缺聘書(含預聘)前已上傳學程修畢證書至台積履歷系統、(取得最高學歷)畢業後直接加入台積者。
- 2. 半導體學程科目之必修/必選修/選修、課程抵修採認規定,不代表在校課程修業規範。
- 3. 報名後未修畢本學程者,僅無法獲得本學程之修畢證書,不影響學生在校任何成績或表現。
- 4. 報名半導體學程者,將有機會受邀參加學程專屬系列活動。
- 5. 「取得學程修畢證書,保證面試」適用範圍僅限台積公司台灣廠區(TSMC Taiwan),不適用海外子公司。
- 6. 台灣積體電路製造股份有限公司針對以上方案保留修改及解釋之權利。

4

→ 科目對照表

啟用 Windows 移至 [設定] 以啟用 W

(虛擬)學程 6 好處



1 台積業師講授專屬課程(特定學程)

1

獲頒修畢證書

2 有機會參與NTC課程(特定學程)

2

獲學程獎勵金

多訪台積晶圓廠/設備商

4

受邀參加學程專屬系列活動



台積公司「新人訓練中心」強化半導體人才競爭力

© 2025 TSMC, Ltd **TSMC Property**





加入台積 共創奇蹟的貼文



感謝所有同學熱情參與活動~

你們每一次的努力學習,都是邁向半導體世界的重要一步 <u>《</u> 現在就來揭曉這次的幸運得主吧~ *

- ₹ 頭獎 (智慧型手錶 Apple Watch S10): 中正大學 林O珅
- 🞧 貳獎 (藍芽耳機 AirPods 4):陽明交大 周O霖、陽明交大 開O琳、逢甲大學 邱O瑜
- 參獎 (積星充電組):臺灣科大 歐O亘、臺灣科大 王O傑、逢甲大學 林O儀、臺北科大 楊O銘、臺北科大 林O臻、雲林科大 陳O益、中山大學 陳O廷、成功大學 王O翔、清華大學 柯O萱、屏東科大 劉O 穎
- ▶ 兌獎方式:請在收到獲獎通知信件的 1周內,回傳以下資料,
- ☑ 學校成績單(佐證修課紀錄)
- ☑ 活動參與證明
- ▼ 在學證明
- 🗸 獎品寄送地址

大家快打開信箱看看,你是不是那個幸運得獎者 搫

抽獎活動告一段落,但學習之旅才正要展開🎉

這次沒中獎的同學也別氣餒,

只要努力累積點數,中獎機會就會越來越大。

下一次活動等著你來挑戰~~

台積公司期待各位夥伴能繼續修習半導體相關課程, 累積更多知識和技能,未來成為科技領域的明日之星,

頭獎



智慧型手錶 1名

貳獎



藍牙耳機 3名

參獎



積星充電組 10名

tsmc

Serial number: 202509120813-17210039

© 2025 TSMC, Ltd 36

tsmc

問題與交流

https://careers.tsmc.com/education



掌握 半導體 知識 成為 定義未來 科技的領導者

Q1 如何報名半導體學程?





https://careers.tsmc.com/education

至學程網頁登錄

(選擇與中興大學合作學程報名)

台積將不定期通知學程相關系列活動。

Q2 學程科目採認的課程可否回溯?



可以 ^^

凡符合申請資格者(中興大學各系/所全時在學學生),

報名後即可追溯其大學迄今所修習過之學程科目,

惟提交學程修畢證書申請時,參照之科目對照表以所在學校半導體學程為準。

© 2025 TSMC, Ltd 39

Q3 大學非就讀中興,所修對應學程科目的課程會採認嗎?



有機會!但須提出課程採認申請

(<mark>非透過學程系統</mark>,請下載科目對照表 - 課程延續採認申請表)

半導體學程合作學校:

- 1. 該校與中興學程科目對照表皆有列入者,直接採認(即抵修)。
- 2. 該校學程科目對照表未列入,採實質審查,需於提出課程採認申請時,檢附 所欲採認課程(抵修與被抵修)之課程目標、課程大綱供檢視,內容相符程度 逾70%者,即予以採認。

非半導體學程合作學校:成績及格科目皆可提出採認申請

(原則同上述第2點)

Q4 與台積攜手合作半導體學程的學校有哪些?



學程類別	清大 卮		明 大 臺	養皇北 、科大		中央	中興	中正	逢甲	元智	中原			高雄 科大		
半導體 元件整合 製程模組 設備工程	•			Perzi.	•					2				3		
電路設計 智慧製造	•	Carox	Service Contraction of the Contr				· Operi					SAC ST	0000	*依合作	開辦順	序排列
							0250912	0813-17	210039							

© 2025 TSMC, Ltd 41 TSMC Property

Q5 本校其他系所課程未被列入科目對照表中, 但課程內容一樣,課程名稱也雷同,可否採認?



有機會!但須提出課程採認申請(附件:台積電半導體學程_課程採認申請表)

採實質審查,需於提出課程採認申請時,檢附所欲採認課程之課程目標、課程

大綱供檢視,內容相符程度逾70%者,即予以採認。

(原則上由主持系所審核後決議是否納入)

36 Har Harmbot. 202000 1200 10 1721000

© 2025 TSMC, Ltd

Q6 半導體學程修畢證書申請資格及方式?



申請資格:

申請時需仍為中興各系/所之全時在學學生(即畢業前提出申請)。

申請方式:

提出半導體學程修畢證書申請(於學程系統提出申請)

同時上傳

- 成績單(對應修畢的課程以顏色作註記)
- **學程採認(抵免)申請結果**(如果曾經申請抵免)

© 2025 TSMC, Ltd 43

提交半導體學程修畢證書申請前注意事項



- 僅受理審查已報名半導體學程者提出之申請
- 學程獎勵金僅適用於滿足以下四個條件者:
 - 1. 碩一(含)前,已報名學程
 - 2. 修業平均成績達80分(含)以上
 - 3. (取得最高學歷)畢業後直接加入台積者
 - 4. 獲台積正職職缺聘書(含預聘/研發替代役)前,完成認證申請,並上傳學程修畢證書至 台積履歷系統

© 2025 TSMC, Ltd 44 TSMC Property

Q7總修習課程數多於修畢門檻,會有實質差異嗎?



不會X

建議可以從修畢學程科目中,挑選成績最好的採認課程來申請。

(相同學程科目僅會採認1門課程)

半導體關鍵學能 (應完成必修 <mark>1</mark> 門+選修至少 <mark>4</mark> 門)											
# 學程科目名稱	學程訂定 必/選修	採認課程名稱	採認課程代碼	學分數	修畢課程 (打V)	分數 (百分制)	開課系/所	課程程度 (下拉選單)	開課學期 (下拉選單)		
1 半導體元件物理	必	固態電子元件	3433	3			電機工程學系	大學部	下學期		
30		元件物理	6840	3			電機工程學系	研究所	上學期		
		半導體元件物理	4208	3			材料科學與工程學系	大學部	上學期		
		半導體物理與元件(-)	6615	3		物理學系 研究所	研究所	上學期			
2 工程數學	選	工程數學(二)	2325/ 2326	3			電機工程學系	大學部	上學期		
		工程數學(二)	2406	3			材料科學與工程學系	大學部	下學期		
		工程數學(二)	2402	3	•		化學工程學系	大學部	下學期		
		工程數學(二)	2327/ 2328	3			機械工程學系	大學部	下學期		
		工程數學(二)	2208	3			生物產業機電工程學系	大學部	下學期		
		物理數學(二)	2339	3			物理學系	大學部	下學期		
		化學數學	2248	3			化學系	大學部	上學期		
3 固態物理導論	選	固態物理導論	4299	3			電機工程學系	大學部	上學期		
		固態物理導論	4118	3	•		材料科學與工程學系	大學部	下學期		
		固態物理	6772	3	•		物理學系	研究所	下學期		
4 近代物理	選	近代物理	2280	3			物理學系	大學部	上學期		